

## Einpolige Einspeisungen und RF-Klemmen



## Produkte

- Rundsteckverbinder
- Rechteckige Verbinder
- DC- und RF-Einspeisungen
- Batterie- und Kondensator-Enddichtungen
- TO-Header, Flat-Packs, Plug-Ins und Plattformen
- Komplexe bearbeitete Gehäuse für opto-elektronische, mikro-elektronische und Mikrowellen-Baugruppen
- Thermomanagement-Lösungen

## Fähigkeiten

- Designkompetenz und Modellierungsfähigkeiten
  - Mechanisch, elektrisch und thermisch
- Erfahrene Konstruktions- und Prozessingenieure
- Reaktionsfähige Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter
- Hochtemperatur-Löt- und Glasversiegelungsöfen
- Niedertemperatur-Lötintegrationsöfen
- Chemische Reinigungsanlage
- Galvanisierungswerkstatt vor Ort
- Inspektions- und Testeinrichtungen
- Qualitätssystem registriert nach ISO 9001:2000 und AS9100:2004
- Zugang zur globalen Lieferbasis
- 50.000 sq ft Anlage.
- Zukunftsorientierter Geschäftsplan

AMETEK Aegis und Glasseal Products (GSP) stellt das vollständigste Sortiment an hermetisch versiegelten einpoligen Durchführungen für niederfrequente Leistungs- und Signalzwecke sowie für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen her.

Unsere Einzelstiftdurchführungen sind mit geflanschten oder geraden Gehäusen, angepassten oder Kompressionsdichtungen, massiven oder rohrförmigen Stiften erhältlich. Hohe Stromanforderungen können durch den Einsatz von kupferkernigen Stiften erfüllt werden. HF-Klemmen erfüllen die Designparameter von SMA-, SMP- (GPO) und SSMP- (GPPO) Produkten.

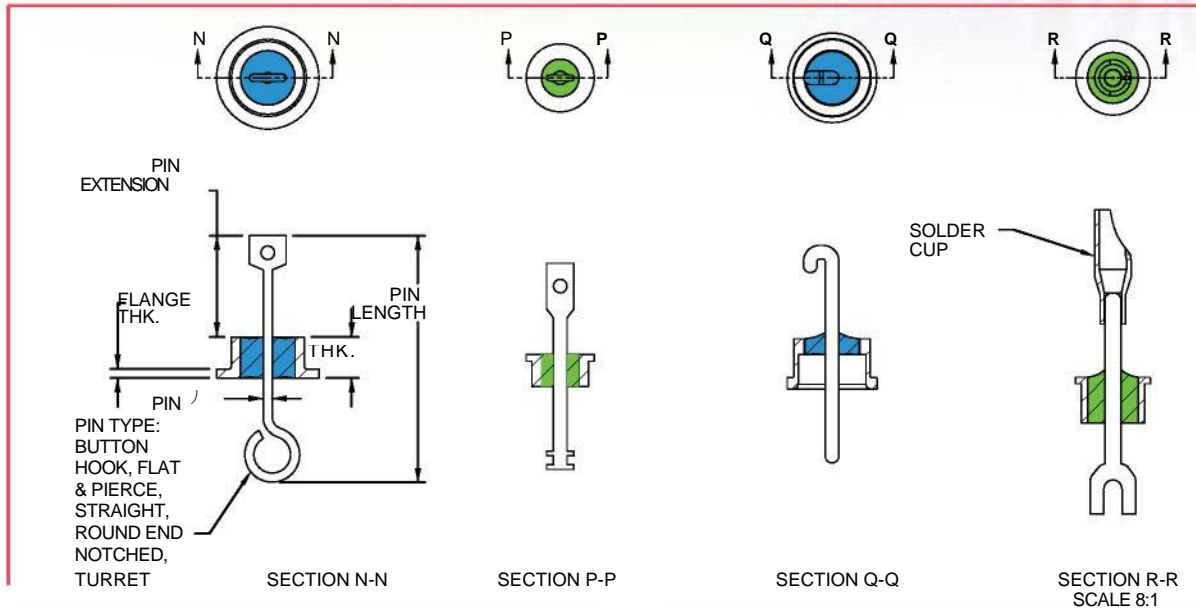
Die Klemmen sind für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und halten den harten Anforderungen bei der Montage in einer Vielzahl von elektrischen und elektronischen Produkten stand. Die Endanwendungen sind so vielfältig wie Telekommunikationsinstrumente, industrielle Sensoren und Luft- und Raumfahrtssysteme, bei denen diese Glas-Metall-Dichtungen ein extrem hohes Maß an Hermetizität über Zeiträume von oft Jahrzehnten aufrechterhalten müssen.

Dieses Datenblatt bietet einen Ausgangspunkt für Ihr Produktdesign und veranschaulicht die vielen Optionen, die zur Verfügung stehen, um Ihre Montage- und Funktionsanforderungen zu erfüllen. Aegis und GSP verfügen über eine umfangreiche Design-Bibliothek, die viele Größen von Durchführungen und Klemmen umfasst. Wir laden Sie ein, sich mit unseren Kundenbetreuern in Verbindung zu setzen, um Lösungen für Standarddesigns oder kundenspezifische Anforderungen zu finden. Elektrische und umweltbezogene Leistungsdaten unserer fertigen Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

### Mindestleistungskriterien:

- Hermetisch dicht: Leckagerate weniger als  $1 \times 10^{-8}$  cc/sec von Helium bei 15 PSI
- Isolationswiderstand: Größer als 10.000 Megohm bei 500 VDC
- Dielektrische Widerstandsspannung: Minimum von 500 V rms
- Temperaturschock: Keine Anzeichen von Schäden, die den Betrieb der Klemmen bei  $-65^{\circ}\text{C}$  ( $-85^{\circ}\text{F}$ ) bis  $+125^{\circ}\text{C}$  ( $+257^{\circ}\text{F}$ ) beeinträchtigen.

# Single Pin Feed Thru

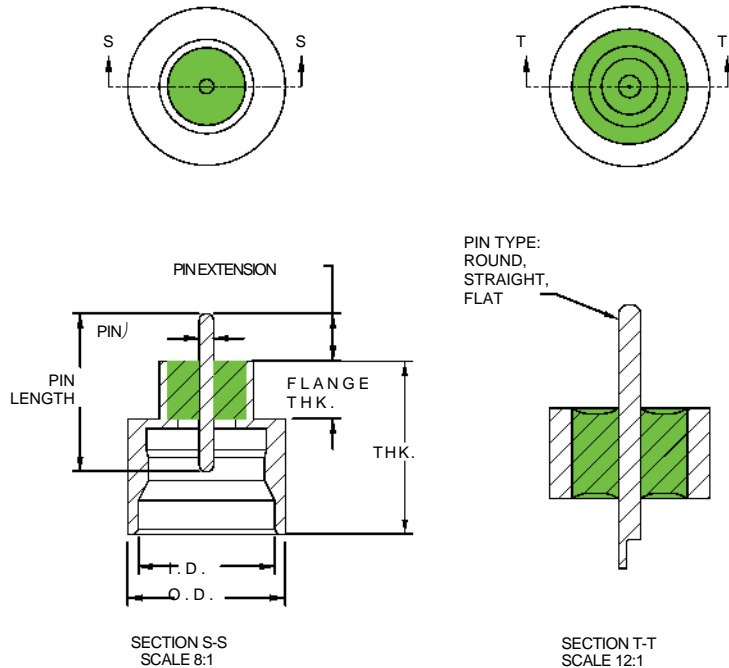


CURRENT RATING		
TERMINAL DIAMETER	CURRENT RATINGS AMPS.	
	STANDARD	HIGH CONDUCTIVITY
0.030	3	4.5
0.040	5.5	8.2
0.050	7.5	11.2
0.060	10	15
0.080	15	22.5
0.093	20	30

DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE	
TEST VOLTAGE (Vrms)	GLASS INSULATION REQUIRED BETWEEN BODY & PINS (INCHES)
500	0.015
750	0.022
1000	0.030
1500	0.043
2000	0.058
2500	0.072

DESIGN FEATURE	DESIGN GUIDELINE
BODY Ø	To fit case
BODY MATERIAL	Typically Kovar, cold-rolled steel, stainless steel
GLASS THICKNESS	0.05" minimum
PIN LENGTH	As required
PIN EXTENSION	As required
PIN MATERIAL	Typically 52 Alloy, cold-rolled steel, Kovar
PIN TERMINATION	To fit next assembly
PLATING	To fit next assembly

# RF Terminals



DESIGN FEATURE	DESIGN GUIDELINE
BODY MATERIAL	Typically stainless steel, Kovar
GLASS THICKNESS	0.050" minimum
PIN LENGTH	As required
PIN EXTENSION	As required

MATERIAL	DIELECTRIC CONSTANT
CORNING 7070	4.1
CORNING 7052	4.9
CORNING 9013	6.65

## Über uns

Aegis und Glasseal Products (GSP) versiegeln seit über 50 Jahren Glas mit Metall und gehören zu den vielseitigsten Herstellern von hermetisch versiegelten Verbindungs- und mikroelektronischen Verpackungskomponenten im heutigen Markt. Als eine Geschäftseinheit von AMETEK verfügen Aegis und GSP über ein breites Portfolio an Steckverbindern, Headern, Durchführungen, Enddichtungen und Gehäusen in Glas- und Keramikkonfigurationen. Wir fertigen sowohl Standard MIL Spec Produkte als auch kundenspezifische Designs nach Ihren Zeichnungen und technischen Anforderungen.



485 Oberlin Avenue • Lakewood, NJ 08701 • USA  
 TEL: 732-370-9100 • FAX: 732-370-7107  
[www.ametek-ecp.com](http://www.ametek-ecp.com)



**and in Europe:**  
 AMETEK International  
 49-53 Hazelwood Road • Northampton, NN1 1LG • UK  
 TEL: +44 (0) 1604 233101 • FAX: +44 (0) 1604 232907  
[www.ametek-ecp.com](http://www.ametek-ecp.com)